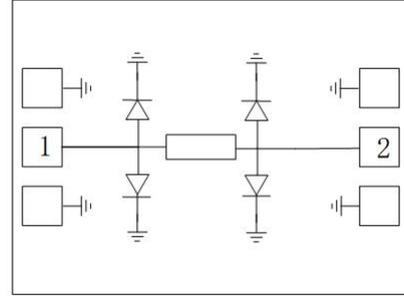




主要特点

- 频段: 0.1 – 6 GHz
- 插入损耗: 0.7 dB
- 限幅电平: 15 dBm
- 回波损耗: 11 dB
- 耐功率: 50W(CW)@2G、25W(CW)@6G
- 芯片尺寸: 1.8×1.3×0.08 mm³

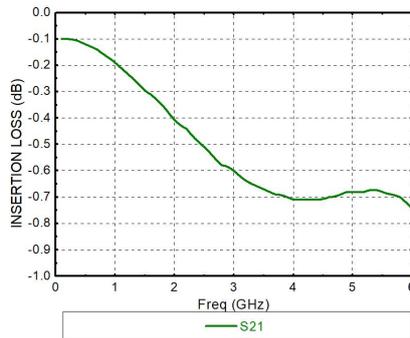
功能框图



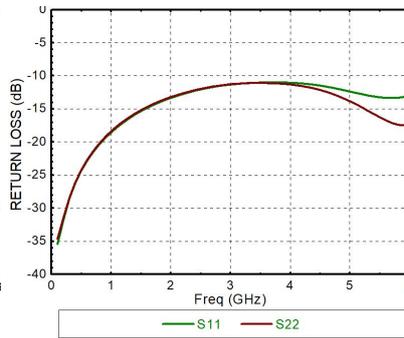
性能指标 (T_A = +25°C)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	0.1 - 6			GHz
插入损耗		0.7		dB
回波损耗		11		dB
限幅电平		15		dBm

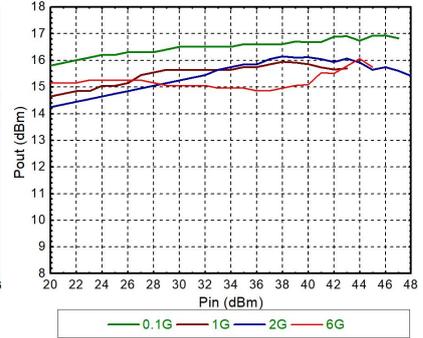
插入损耗



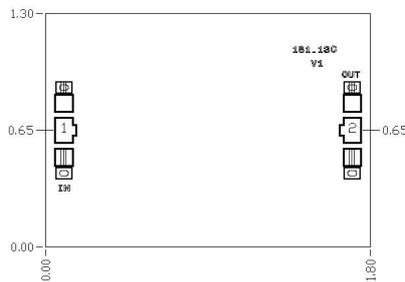
回波损耗



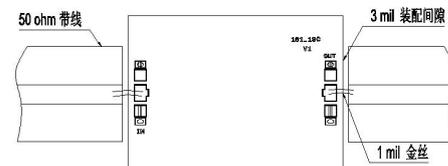
限幅电平



物理参数



装配图



注意事项

- 1、芯片背面镀金
- 2、芯片背面需接地
- 3、推荐共晶烧结工艺安装芯片
- 4、键合焊盘金属化: 金
- 5、键合焊盘尺寸为 120*100 μm²
- 6、外形尺寸公差: ±50 μm
- 7、本产品采用空气桥工艺

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	输入端口, 阻抗 50 Ohm, 无隔直电容
2	OUT	输出端口, 阻抗 50 Ohm, 无隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	50W(CW)@2G, 25W(CW)@6G 25° C
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C